

PRESS RELEASE

報道関係各位

**SMIC**

2024年12月2日

千住金属工業株式会社

新製品や最新技術のご紹介&はんだ付け体験コーナー設置や新製品・新技術セミナーにも登壇

## 「第17回 国際カーエレクトロニクス技術展」に最大規模で出展

会期：2025年1月22日(水)～24日(金) 会場：東京ビッグサイト

はんだ付け材料を主軸とした接合技術のトータルソリューションを提供し、次世代技術をグローバルに展開する、千住金属工業株式会社（本社：東京都足立区、代表取締役社長：鈴木良一）は、2025年1月22日（水）から24日（金）の3日間、東京ビッグサイトにて開催される「第17回 国際カーエレクトロニクス技術展」に出展いたします。

Together. Beyond Limits.  
**AUTOMOTIVE WORLD 2025**  
(オートモーティブワールド)

第17回 国際 **カーエレクトロニクス技術展**  
(カーエレJAPAN)

会期：2025.1.22(水)～24(金)  
会場：東京ビッグサイト

皆様のご来場をお待ちしております

Joint commitment to a cooler future.

「国際カーエレクトロニクス技術展」は、8つの構成展示会からなる「オートモーティブ ワールド -クルマの先端技術展-」のうちの1つで、カーエレクトロニクスの進化を支える半導体や電子部材、ソフトウェア、テスト技術、製造装置などが一堂に集う、本分野における国内最大級の専門展です。17回目となる今回は、出展社数1,800社、来場者数90,000名と、前回は上回る規模での開催が見込まれています。

当社は、同展の中でも最大級の規模で出展を予定しており、『Joint commitment to a cooler future.』をテーマに据え、「はんだ付けで技術と技術をつなぎ、人々の生活や地球の未来へつなげる」というコンセプトの元に、次の3つのカテゴリで提案をいたします。

### 1) 次世代技術と車載関連

- 新製品「TLP 接合材料」のご紹介
- 「無加圧銀焼結ペースト」のご紹介

上記2点のパワー半導体向け新製品に加え、車載 ECU などの基板実装向けの製品も展示いたします。

## 2) カーボンニュートラル

- 新製品「MILATERA BAR」など低温はんだ付け材料のご紹介
- 「BITHUS-Wave MTF-300」低温ウェーブはんだ付け装置のご紹介

世界で初めて実用化された低温はんだのフロー工法は、大手電機メーカーで採用が進んでおり、当社ではこの工法に対応したはんだ付け装置とはんだ付け材料を展示いたします。

## 3) 環境への取り組み

- SMIC グループのリサイクルシステムのご紹介

はんだの生産過程で発生する端材を効率的に再利用し、廃棄物を限りなくゼロに近づける取り組みとともに、お客様の現場で発生するドロスや使用済みはんだの回収・リサイクル・再製品化のプロセスをご紹介します。



※画像はイメージ図です。デザインは変更となる場合があります。

はんだは、金属同士を接合・固定し電気を流すための重要な素材であり、エレクトロニクスや自動車、インフラ・パワーなど、多岐にわたる業界で幅広く使用されています。半導体が「産業のコメ」と呼ばれるように、はんだもまた現代の製造業に欠かせない存在です。

はんだ材料及びはんだ付け装置の研究・開発・製造まで、はんだ業界のリーディングカンパニーである当社は、新製品や最新技術をご紹介しますだけでなく、はんだ付け体験ができるコーナーや、新製品・新技術セミナーにも登壇し、より専門的な技術情報をお届けいたします。

皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

## ■展示会概要

- ◎名 称：第 17 回 国際カーエレクトロニクス技術展
- ◎会 期：2025 年 1 月 22 日（水）～24 日（金） 10:00～17:00
- ◎会 場：東京ビッグサイト（東京都江東区有明 3-11-1）
- ◎展示棟：東ホール
- ◎ブース番号：E45-32
- ▶公式サイト：<https://www.automotiveworld.jp/tokyo/ja-jp/about/car.html>
- ▶来場登録（招待券）：<https://www.nepconjapan.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1218402800128612-RBF>

## ■新製品・新技術セミナー～New Tech Trend～

- ◎タイトル：SiC パワーモジュールの高温動作を支える TLP 接合材料  
高温動作を支える接合材として、はんだと同様に扱え、優れた耐熱性を発揮する TLP 接合材料を開発しました。その原理や特徴についてご紹介いたします。
- ◎登壇者：研究開発部 ハンダテクニカルセンター 研究員 佐々木智揮
- ◎日 時：2025 年 1 月 23 日（木） 14:00～14:30
- ◎会 場：新製品・新技術セミナー会場
- ◎定 員：50 名
- ◎参加方法：当日セミナー会場までお越しください。先着順にて受付となります。

---

## ■会社概要

会社名：千住金属工業株式会社  
本社所在地：〒120-8555 東京都足立区千住橋戸町 23 番地  
代表取締役社長：鈴木 良一  
設立：1938 年 4 月 15 日  
資本金：4 億円  
Web サイト：<https://www.senju.com>

本件に関するお問合せ先  
千住金属工業株式会社 広報宣伝部  
E-mail：[web@senju.com](mailto:web@senju.com)